

Information Meeting 2009

2009年10月16日
株式会社村田製作所



市場環境をめぐる認識・取り組み姿勢



既存市場

- 先進国における機能の高度化、利便性向上のニーズ
 - 新しい需要創造の牽引役
 - 得意先の課題解決に貢献できる体制の充実をはかる
- 新興国における低価格機器の普及
 - 先進国市場でも機能を限定し、価格を抑制した機器の広がり
 - 低価格志向の市場にも徹底的に取り組む

新しい市場

- 自動車、ヘルスケア、エネルギー・環境市場など今後の成長が見込める分野での事業立ち上げ・拡大に取り組む

利益目標



- 『今後3年以内に安定的に2桁の営業利益率に』
- 『継続的な利益を伴った成長路線への回帰』

事業体質強化の取り組み

①新商品開発力の強化

- 小型・薄層・大容量の最先端領域での開発力強化、セラミック以外のコンデンサの需要領域への拡大
- 用途特化型商品の開発



積層セラミックコンデンサ

②コスト競争力の強化

- 『生産性2倍』の取り組み
 - 海外生産の拡大
- アジア同業とも十分に競争のできる低コスト化を実現

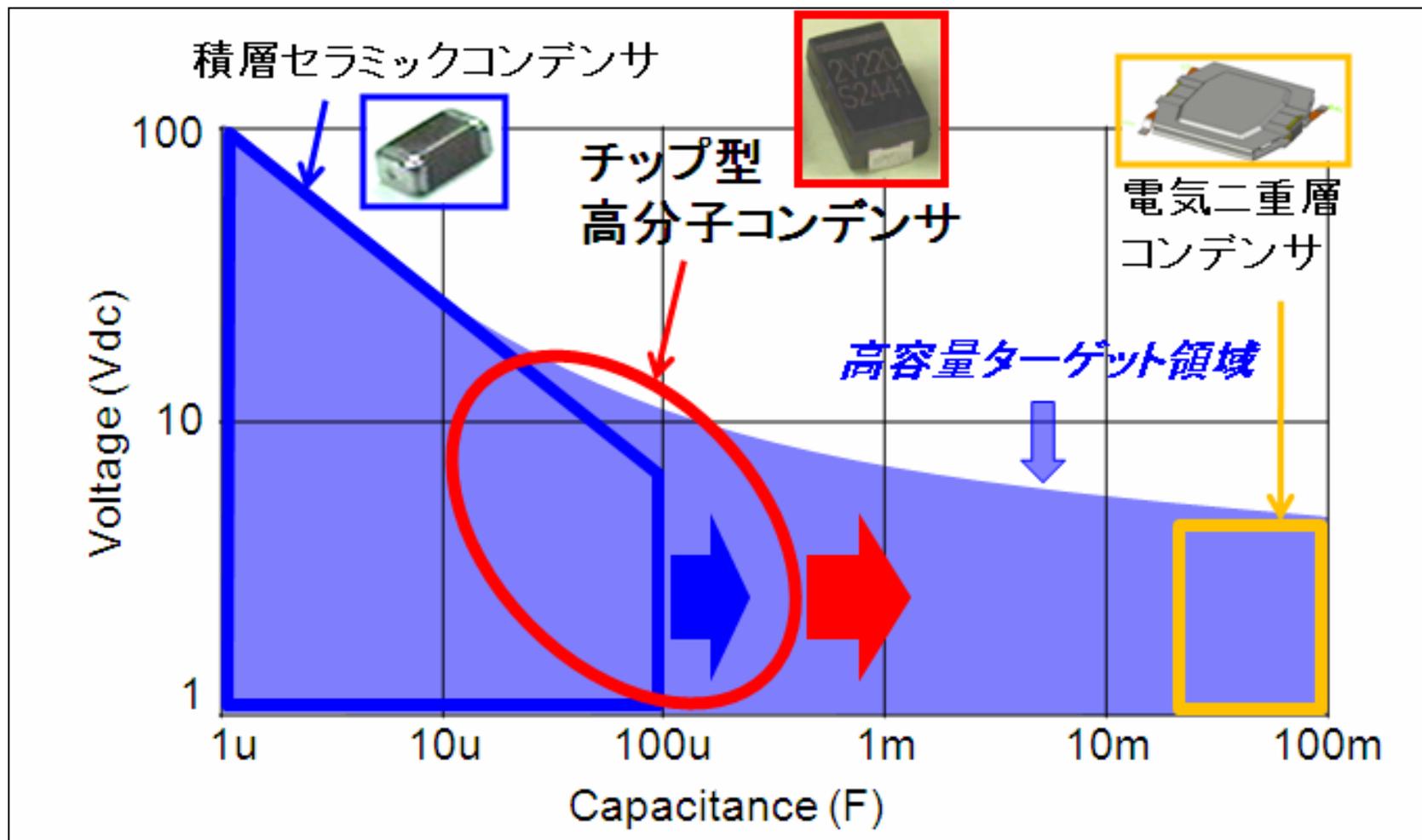
③生産能力の確保

- 需要の拡大領域の見極め、拡大領域への適切な能力確保

④「キャパシタハウス」の取り組み

- 機能性高分子アルミ電解コンデンサ
- 電気二重層コンデンサ
 - セラミックコンデンサよりも高容量の領域をカバー
 - より広いキャパシタソリューションを提供できる体制を整える

市場動向・取り組み状況 (1)コンデンサ



移動体通信市場の拡大

- マルチモード・マルチバンド化した携帯電話の拡大
 - ・ 3G端末の構成比率は2009年：2割→2012年：4割
 - ・ 3Gでのバンド数の増加、GSM/UMTSをサポートするLTE端末
→ 携帯電話1台当たりのバンド数の増加傾向は続く

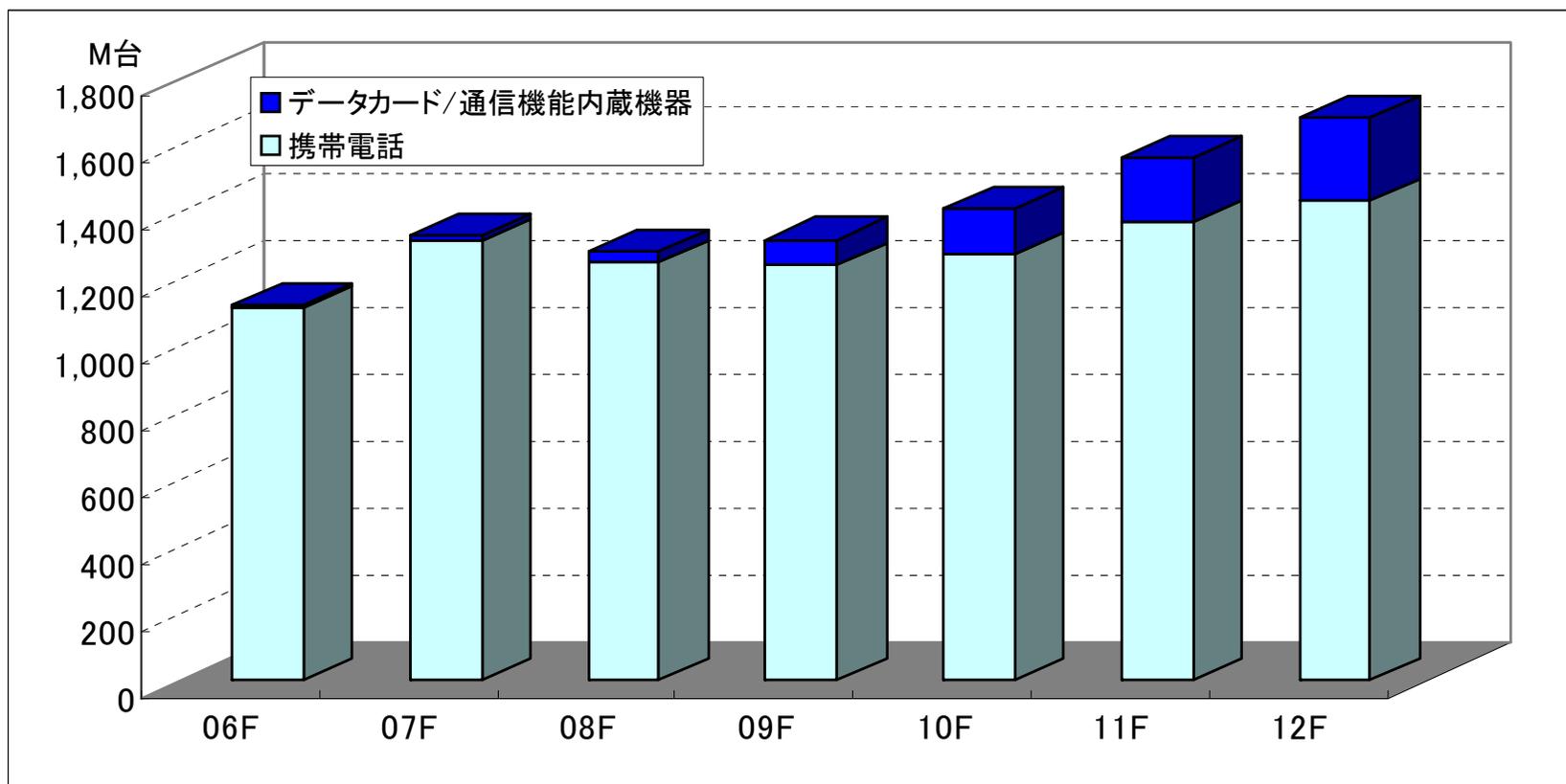
- 従来型の携帯電話の枠を超えた需要の広がり
(高速データ通信需要の拡大)
 - ・ 3G通信機能を有したノートPC用のデータカードの増加
 - ・ 通信機能内蔵のノートPCの普及
 - ・ スマートフォン市場の拡大
 - ・ ダイバシティ回路の追加

市場動向・取り組み状況 (2) 高周波部品



移動体通信市場の拡大

■ 部品需要台数の見通し



市場動向・取り組み状況 (2) 高周波部品

移動体通信市場の拡大

- SAWデバイスの需要が大幅に拡大
- 多層モジュールの需要も拡大
 - ・ マルチバンド・マルチモード化の進展に伴い、高周波回路が複雑化し、モジュール化のニーズが高まる
 - ・ LTCCを用いたモジュールの小型化技術を活かし、フロントエンドモジュール事業の拡大をはかる

近距離無線通信モジュール

- 無線LAN搭載率の伸展
- 収益改善の取り組み



無線LANモジュール

市場動向・取り組み状況

(3)ノイズ対策部品・チップコイル



高周波用コイル

- 携帯電話でのバンド数増加に伴う員数増
- 小型化ニーズにも対応



高周波用コイル

パワーインダクタ

- 携帯電話をはじめとした小型機器向け中心の事業展開
- 今後、AV・EDP機器向けのラインアップを強化

ノイズ対策部品

- 主力のチップフェライトビーズの売上拡大

ジャイロ

- デジタルスチルカメラの手ブレ補正用の
圧電ジャイロ
- カーナビ用のMEMSジャイロ



MEMSジャイロ

ショックセンサ

- HDDの衝撃検知用途、ローテーション検知用途で単量増加

市場動向・取り組み状況 (5) 圧電セラミック技術の応用



メカトロニクスデバイス事業

- 圧電セラミック技術と、生産技術で培ってきた機構設計技術、精密加工・流体シミュレーション技術などを組み合わせた事業

- 圧電ブローア
 - ・圧電体セラミックスを利用した送風デバイス
 - ・小型モバイル機器における熱対策の重要性増大
→従来型のファンの搭載が困難な機器内での空冷用途
 - ・その他の用途開拓

市場動向・取り組み状況 (5) 圧電セラミック技術の応用



メカトロニクスデバイス事業

- 圧電ポンプ
 - ・モバイル機器向けの小型燃料電池用に開発
 - ・燃料電池の普及とあわせた市場の拡大を目指す

その他圧電デバイス

- 圧電アクチュエータ
- 薄型圧電スピーカー

市場動向・取り組み状況

(6)新しい分野での取り組み

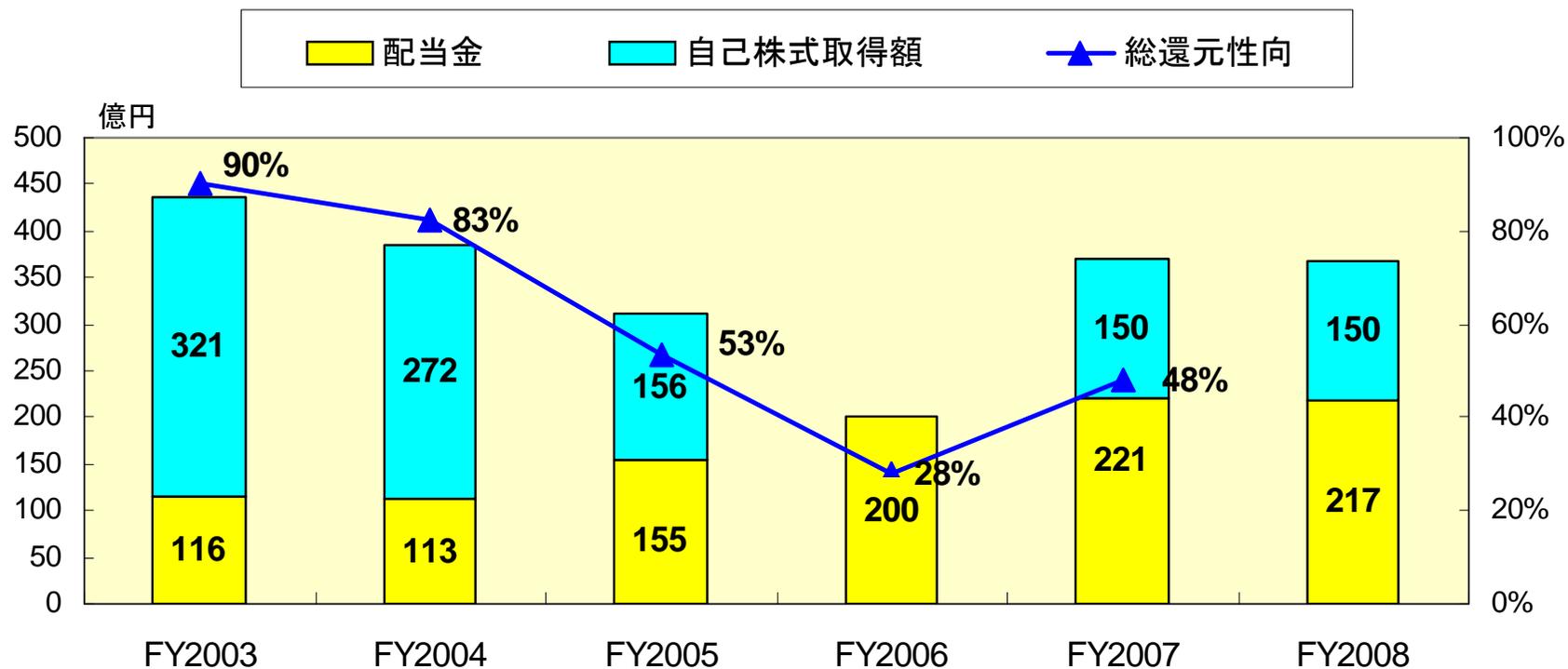


今後の成長市場

- 自動車
- エネルギー・環境
- ヘルスケア

資本政策

総還元性向



当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります。これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1) 当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2) 原材料等の価格変動及び供給不足、(3) 為替レートの変動、(4) 変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5) 当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6) 各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7) 偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

muRata